

Fujikura NEWS

6

2014 No.395

特集 JPCA Show 2014

出展のごあいさつ

平素はフジクラのFPC（フレキシブルプリント配線板）及び関連製品をご愛顧頂きまして厚く御礼申し上げます。

当社のエレクトロニクスカンパニーでは、「“つなぐ”テクノロジーを通じ顧客の価値創造と社会に貢献する」をミッションに、新製品・新技術、量産技術の開発に取り組んでおります。

近年、スマートフォンやウェアラブル端末等のモバイル機器は、ますます軽薄短小化、高速化、多機能化が進み、多種多様な機器とのつながりやすさが強く要求されています。これに伴い、FPCの高密度化や高速伝送化への対応、部品内蔵基板（WABE Package®）をベースとしたモジュール化、プリントッド・エレクトロニクスによる入力・出力デバイス、小型コネクタ、小型放熱部品等の開発を進めております。

当社は、グループ会社の第一電子工業（株）とともに、6月4日（水）から6月6日（金）まで東京ビッグサイトで開催されますJPCA Show 2014の『プリント配線技術展』に出展し、これらの新製品、新技術の一端をご紹介します。また、今回はFPC・コネクタ・配線材料を含めた高周波・高速伝送ソリューション、FPC・放熱部品を組合わせたサーマルソリューションも提案させていただきます。この機会に是非とも当社ブースにお越し頂き、当社の新製品、新技術をご覧頂くとともに、忌憚のないご意見、ご要望を賜りますようお願い申し上げます。



常務執行役員
エレクトロニクスカンパニー 副統括
滝沢 功



JPCA 2014 Show
第44回国際電子回路産業展

日時 2014年6月4日（水）～6日（金）
10:00～17:00

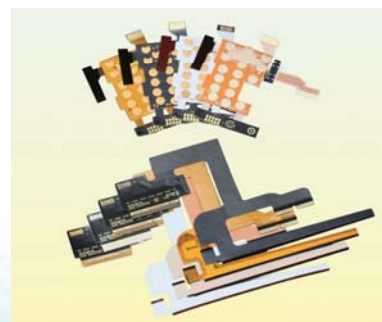
場所 東京ビッグサイト 東5ホール
（フジクラブース 5M-25）

“つなぐ”テクノロジーで未来をひらく！

モバイル機器向けFPC

当社が提供するスマートフォン等のモバイル機器向けのFPCでは、ファイン回路、小径VIA等を適用し、高密度配線及び高密度実装を実現できます。両面・多層FPCの薄型化・柔軟化にも取り組んでおり、お客様のモバイル機器における小型・薄型化等、さらなる高機能化要求にお応えします。

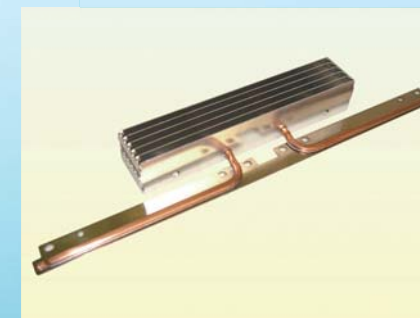
プリント回路事業部 askfpc@jp.fujikura.com



ヒートパイプアセンブリ

ヒートパイプは優れた熱伝導特性、大きな設計自由度で、電子機器の冷却や車載LEDの冷却に幅広く利用されています。当社では細径、薄型ヒートパイプを開発し、スマートフォン等の小型携帯機器への搭載を実現しました。

サーマルテック事業部 netsu-info@jp.fujikura.com



白色FPC

高反射率で耐熱性、耐光性の高い白色FPCです。液晶バックライト、LED照明、DRL (Daytime Running Lights) に代表される車載ランプ等の用途に白色FPCを用いることにより、LEDモジュールの輝度を向上させることができます。白色FPCには白色カバーレイを使用するタイプと白色インクを使用するタイプの2種類があります。

プリント回路事業部 askfpc@jp.fujikura.com



静電容量式タッチセンサ製品

当社は、ノートPCキーボード用メンブレンスイッチや、デジタル家電向けシートキーなどのHMI (Human Machine Interface) 製品、およびFPCやメンブレン配線板などの薄型配線製品を製造しています。これらの製品分野で培われた技術を応用し、ホバー、タッチスライド、クリックの3つのスイッチ機能を有するタッチセンサ、配線を細くすることで疑似的に透明化したタッチセンサなどの静電容量式HMI製品の開発を行っています。

機能モジュール技術部 ask-mbsw@jp.fujikura.com



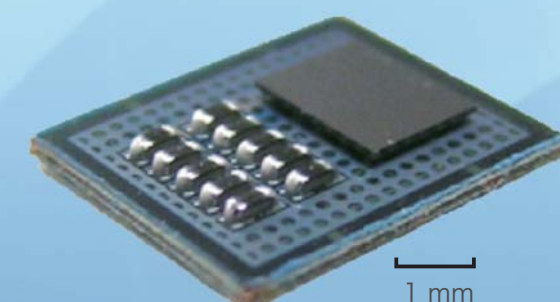
JPCA 2014 Show
第44回国際電子回路産業展

Fujikura

薄型部品内蔵基板WABE package® : Wafer And Board level Embedded Package

WABE Package®は部品を高密度に配置できる薄型基板です。電子回路の占有面積を大幅に縮小できるだけでなく、部品間を最短距離で接続できるため、伝送ロスやノイズの低減に有効です。裏面研磨したICを極薄のポリイミドフィルムでサンドイッチする構造により、部品内蔵基板として世界最薄レベルの0.22 mmを達成しました。ポリイミドの持つ柔軟性を活かし基板の一部に可撓性を付与することも本基板の特長です。

WABE Package®を応用した機能モジュール



断面構造



メディカル事業推進室 askwabe@jp.fujikura.com

細径USB3.0ケーブルアセンブリ

当社が提供するUSB3.0ケーブルアセンブリは標準品のみではなく、収納性、柔軟性を重視した特殊構造の細径ケーブルアセンブリも取り揃えています。更により高速なUSB3.1 typeCや長尺化などの特殊用途アセンブリ品を開発しています。お客様が必要とするケーブル長や使用環境に応じて最適な商品を提供します。

Standard A - Micro B アセンブリ



極細同軸ケーブルアセンブリ

当社の極細同軸ケーブルは、高速伝送特性や耐屈曲・捻回特性に優れ、省スペースかつ柔軟に配線可能です。その特性を活かして、電子機器内配線材としてノートPCやカメラなど各種モバイル端末で使用されています。近年では、高速伝送が要求されるディスプレイ用、Webカメラ用、アンテナ用 (RFケーブル) などに使用されています。その中でも特に、ヒンジを用いて屈曲・捻回を行う部位には数多くの採用実績があります。

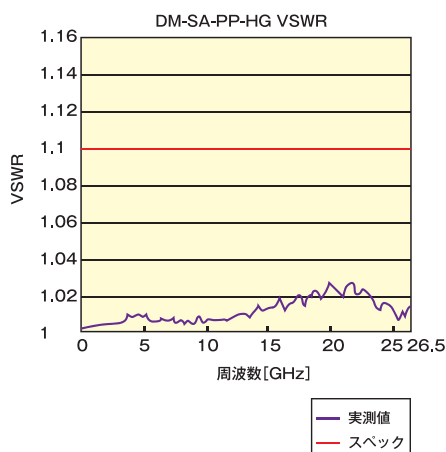
電子材料事業部 askecd@jp.fujikura.com



電子材料事業部 askecd@jp.fujikura.com

第一電子工業(株)は、フジクラグループの一員として、 JPCA Show 2014に出展します

HG Series 高性能同軸アダプタ



HGシリーズは『コネクタの持つ性能を最大限に引き出す』をコンセプトに誕生した同軸アダプタです。コネクタ内部のインピーダンスのミスマッチを最小に抑えるように構造を突き詰め、製造も高水準の加工技術で超精密加工を実現し、優れた高周波特性を持つコネクタを提供します。

主な特長

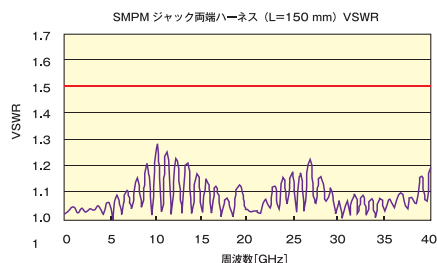
- 高水準の高周波特性を有し、あらゆる通信機器に適用可能です。
- コネクタ部での信号劣化が少なく、製品評価にも最適です。
- 多彩なバリエーション、表面処理に対応します。

製品仕様

項目	仕様
特性インピーダンス	50 Ω
定格電圧	AC500 V(r.m.s.)
耐電圧	AC1,000 V(r.m.s.)/1分間
絶縁抵抗	1,000 M Ω 以上(DC500 V)
接触抵抗	3 m Ω 以下
VSWR	1.1 以下(DC~26.5 GHz)

※上記仕様はDM(SMA)形のもので。

SMPM Series 高周波対応小型同軸コネクタ



SMPMシリーズはMIL-STD-348Aに準拠するSMP形コネクタを小型化しつつ高速伝送に対応した超小型同軸コネクタです。光通信におけるLN変調器や高速大容量伝送装置内で使用されます。

主な特長

- 嵌合方式はプッシュオン方式で専用工具により容易に接続・離脱が可能です。
- 一對のプラグレセプタクルと中継アダプタの組合せによるフローティング接続が可能です。
- SMP形コネクタを小型化し、2連、4連など狭いスペースに複数、並列実装することが可能です。

製品仕様

項目	仕様
特性インピーダンス	50 Ω
定格電圧	AC160 V(r.m.s.)
耐電圧	AC500 V(r.m.s.) / 1分間
絶縁抵抗	5,000 M Ω 以上(DC500 V)
VSWR	1.5以下(DC~40 GHz)

株式会社フジクラ

〒135-8512 東京都江東区木場1-5-1

発行:2014年6月 No.395 編集兼発行責任者:細谷英行

<http://www.fujikura.co.jp>

関西支店 TEL:06-6364-0373 中部支店 TEL:052-212-1880
総合営業推進部 TEL:03-5606-1095 東北ブロック TEL:022-266-3344

九州ブロック TEL:092-291-6126



ユニバーサルデザイン(UD)の考え方にに基づき、より多くの人に
見やすく読み間違えにくいデザインの文字を使用しています。